

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 1 月 17 日(17.01.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/008684 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08K 5/3415 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) C08L 65/00 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/066995
- (22) 国際出願日: 2012 年 7 月 3 日(03.07.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-155983 2011 年 7 月 14 日(14.07.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱瓦斯化学株式会社(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 鹿島 直樹(KASHIMA, Naoki) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 長谷部 恵一(HASEBE, Keiichi) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 四家 誠司(SHIKA, Seiji) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 馬淵 義則(MABUCHI, Yoshinori) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 加藤 禎啓(KATO, Yoshi-

hiro) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR PRINTED WIRING BOARDS

(54) 発明の名称: プリント配線板用樹脂組成物

(57) Abstract: Provided is a resin composition which enables the formation of a roughened surface having a low roughness degree on the surface of an insulation layer in a printed wiring board material when used on the insulation layer regardless of the roughening conditions employed and also enables the formation of a conductive layer having excellent adhesion properties, heat resistance, heat resistance under absorption of moisture, thermal expansion properties and chemical resistance on the roughened surface. A resin composition comprising (A) an inorganic filler that is soluble in an acid, (B) a cyanic acid ester compound and (C) an epoxy resin.

(57) 要約: プリント配線板材料における絶縁層に使用した場合に、粗化条件によらず絶縁層表面に低粗度な粗化面を形成でき、該粗化面に形成される導体層の密着性、耐熱性、吸湿耐熱性、熱膨張性および耐薬品性にも優れた樹脂組成物を提供する。酸に可溶な無機充填材(A)、シアン酸エステル化合物(B)、及びエポキシ樹脂(C)を含む樹脂組成物。



WO 2013/008684 A1